

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250903

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他
参与单位名称 及人员姓名	2025 年 9 月 3 日下午 14:00~15:00：海通富基金：刘海啸、吴昊、彭志远、王经纬、赵莹洲、王振邀、聂宇霄；财达证券：李海潮；长江证券：杨洋；投资者：陈文生，共 10 名投资者及证券人员
时间	2025 年 9 月 3 日下午 14:00~15:00
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2025 年 9 月 3 日下午 14:00~15:00：董事会秘书杨平彩女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下： 问 1：公司营业收入的结构是怎样的？ 答：2025 年上半年度，公司实现营业收入 17.32 亿元，较上年同期增长 14.00%，主要由半导体业务及打印复印通用耗材业务构成。在主营业务收入中：1、公司半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现主营业务收入 9.43 亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），同比增长 48.64%，营业收入占比提升至 54.75%水平。2、打印复印通用耗材业务实现营业收入 7.79 亿元（不含通用耗材芯片）。公司将努力持续提升半导体业务的收入规模，并从而带动公司整体利润水平的增长。 问 2：公司的研发投入会持续保持现在的水平吗？ 答：2024 年度公司研发投入金额 4.62 亿元；2025 年上半年公司依然维持较高研发投入力度，研发投入金额 2.50 亿元，较上年同期增长 13.92%，占营业收入的比例为 14.41%。技术创新实力一直是鼎龙的核心竞争力之一，高研发投入为各类新产品及配套资源的快速布局提供了坚实的支撑，创新能力持续提升。 问 3：公司 CMP 抛光垫有哪些竞争优势？ 答：公司是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和

	生产工艺的 CMP 抛光垫供应商，是 CMP 抛光垫国产供应龙头，在 CMP 抛光垫领域形成了较强的综合竞争实力，主要包括：1、产品型号齐全，公司 CMP 抛光垫产品类型覆盖硬垫、软垫，应用节点从成熟制程开始持续扩展，具备配合客户需求快速进行定制化开发、升级迭代的技术实力。2、供应链管控能力强，核心原材料自主化持续推进，这有助于保障产品品质稳定可控，同时提升产品的潜在盈利空间。3、生产工艺不断进步，如良率的提升、生产环节优化等，这提高了生产效率，降低成本。4、CMP 环节核心耗材一站式布局方案逐步完善，系统化的 CMP 环节产品支持能力、技术服务能力、整体方案解决能力持续提升，对相关环节产品的市场推广带来帮助。 问 4：公司 CMP 抛光液的产品未来竞争力如何？ 答：市面上抛光液的型号有很多，鼎龙从 CMP 抛光液的核心原材料研磨粒子开始自主研发，在此基础上成功实现全制程 CMP 抛光液产品布局。2025 年上半年度，在售 CMP 抛光液型号稳定上量，在测品类加速验证、导入。此外，产品组合方案持续完善，多晶硅抛光液与配套清洗液的产品组合方案获得国内主流逻辑晶圆厂客户技术认可，取得“抛光液+清洗液”的组合订单。公司 CMP 抛光液、清洗液产品市场渗透的加深与新品订单的增长，将为全年销售收入的增长注入新动能。 问 5：公司半导体显示材料是否能维持高速增长？ 答：2025 年上半年度，半导体显示材料实现产品销售收入 2.71 亿元，同比增长 61.90%。其中除在售的 YPI、PSPI、TFE-INK 产品在客户端持续放量之外，无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）等新品的客户验证持续推进，目前验证反馈结果良好，争取成为未来显示材料领域新的收入增长点。未来，公司将继续努力推动显示材料产品在面板厂客户端渗透水平的提升，抓住 OLED 显示面板行业下游需求旺盛，中大尺寸应用有望放量，国内 OLED 产能持续快速增长的机遇，促进公司显示材料业务收入保持快速增长态势。 问 6：公司高端晶圆光刻胶公司业务的布局情况怎样？ 答：2025 年上半年，在产品开发方面：公司已布局近 30 款高端晶圆光刻胶产品，超过 15 款产品已送样给客户验证，其中超过 10 款进入加仑样测试阶段，整体测试进展顺利，其中有数款产品有望在今年下半年全力冲刺订单。在产能建设方面：公司潜江一期年产 30 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶产线具备批量化生产及供货能力，同时承担工艺放大的开发重任；二期年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶量产线建设在按计划顺利推进中，计划今年第四季度进入全面试运行阶段。 问 7：公司半导体先进封装材料进展情况如何？ 答：在半导体先进封装材料领域，公司围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、技术难度高、未来增量空间较大的材料产品进行布局，目前主要有半导体封装 PI、临时键合胶两类产品。2025 年上半年度，半导体封装 PI 在售型号数量及覆盖客户数量进一步增加，推动订单增长持续加速；临时键合胶在已有客户持续稳定规模出货中。
--	---

	问 8：公司半导体材料产品在客户端的优势有哪些？ 答：公司在半导体 CMP 制程工艺材料领域的主要产品，包括 CMP 抛光垫、CMP 抛光液及清洗液，以及在半导体显示材料领域的关键产品如 YPI、PSPI、TFE-INK 等，已在国内主流晶圆制造和显示面板企业实现批量销售与稳定供应。凭借优异的产品稳定性与可靠性，以及高效、及时的技术服务支持，公司赢得了下游客户的高度信任，建立了持续稳定的合作关系。客户的信任不仅有力推动了新产品的合作开发与验证进程，也为现有产品的持续放量和迭代优化提供了重要支持。此类深度合作与良性互动，为公司打造创新性材料平台型企业、拓展半导体材料其他关键细分领域奠定了坚实基础，并对实现长期、可持续和高质量的发展形成了坚实支撑。 问 9：公司如何构建自身的专利护城河？ 答：截至 2025 年 6 月 30 日，公司已获授及在申请中的专利共 1,301 项，其中已获得授权的专利 1,052 项，包括外观设计专利 108 项、发明专利 397 项、实用新型专利 547 项；拥有软件著作权与集成电路布图设计 110 项。2025 年上半年度，公司持续完善专利数据库建设，积极布局 CMP 抛光垫、抛光液、柔性显示 PSPI 等主要产品的核心专利，持续加大各类新产品在海内外的不侵权分析及风险排查，为公司创新发展及市场推广保驾护航。2025 年 7 月，公司“一种抛光垫、聚氨酯抛光层及其制备方法（专利号：ZL201710769743.9）”专利被评选为第二届湖北专利奖金奖，彰显公司在核心技术领域突破的成果与知识产权实力。
附件清单	无
日期	2025 年 9 月 3 日